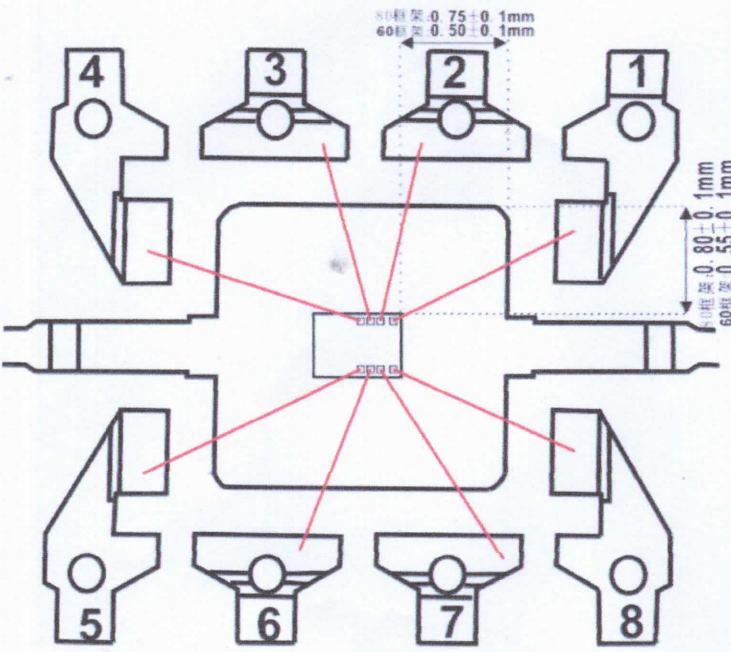
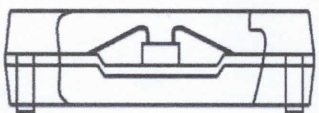

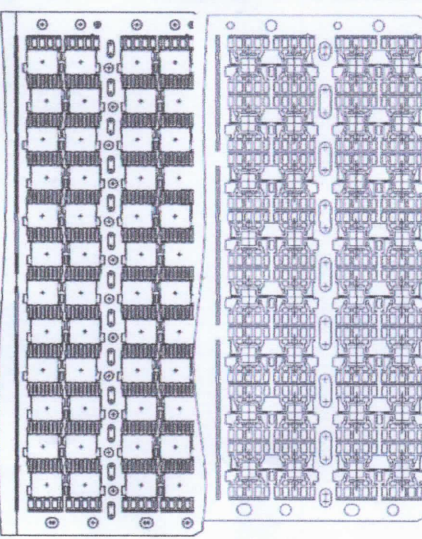

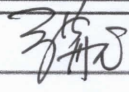


				文件编号	BD-HXQ73-SOP08009			
				文件名称	SOP8L 焊线图			
芯片型号	HS6001	产品名称	HS16P1880		客户代码	HXQ73	版本	A
版本信息:								
版本	修改内容					修改日期	修改人	
A	初版发行					2024-08-28	郭剑	
<div>➡ 进料方向</div> <div></div>								
<div>Side View</div> <div></div>								
<div>Top View</div> <div></div>								
<div>➡ 进料方向</div> <div></div>								
项 目	参数信息			<div>备注:</div> <div>PAD(焊盘)铝层厚度: 1.2um</div> <div>PAD 下方是否有敏感器件?</div> <div>✓有          无</div> <div>客户注意:</div> <div>焊接时, PAD 下方或附近有敏感器件时, 压焊会影响成品率和可靠性。</div> <div><input type="checkbox"/> 试产          <input type="checkbox"/> 直接量产</div> <div>(直接量产我司不予保证良率)</div> <div>客户确认签字:</div>				
划片道宽度	60um							
框架规格	12 排:80*80mil <sup>2</sup> /60*60mil <sup>2</sup> 8 排:80*80mil <sup>2</sup>							
粘胶型号	导电胶							
芯片尺寸	625*450um <sup>2</sup> (含划片道)							
芯片厚度	260±10um							
焊点尺寸	49*49um <sup>2</sup>							
焊点间距	59um							
焊线根数	8 根							
焊线总长	NA							
焊线线径	合金线/20um							
制 定	郭剑	审 核		批 准				
制定日期	2024-08-28	审核日期	2024.8.28	批准日期	2024.08.29			